

WHM1

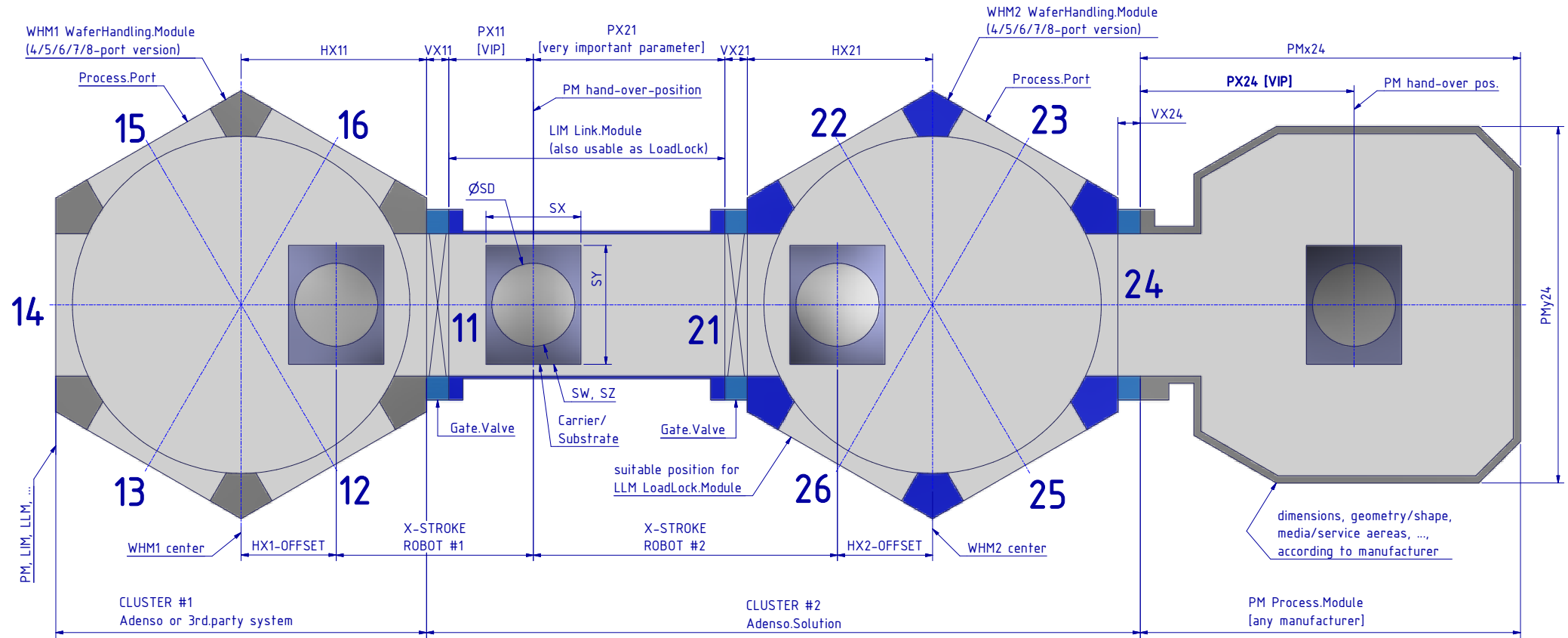
WaferHandling.Module
4/5/6/7/8 ports

WHM2

WaferHandling.Module
4/5/6/7/8 ports

PM24

Process.Module
(any types)



REQUIRED.DIMENSIONS:

Substrate/Carrier.Dimensions:

- rectangular: SX and SY
- circular: ØSD
- thickness: SZ
- substrate/carrier weight: SW

Cluster.Layout:

- number of process ports, e.g. 6 pcs. = WHM6X

Valve.Dimensions:

- VX = valve thickness
- VY = valve width (opening)
- VZ = valva high (opening)

Additional.Dimensions (if available):

- LIM = dimensions of Link.Module

Informal.Dimensions:

- HX = sealing surface to center (WHM)

Process.Dimensions:

- [VIP: very important parameter]
- PX = hand-over-position inside process module to outer sealing surface (w/o gate)
- PMx/y = PM outer dimensions

www.adCLUSTER.solutions

Positionstoleranz / Tolerances of location		Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768		Prüfmaße nach DIN 466-T1	
1	Bohrungen / holes	0,1 mm		Form und Winkelmaß	m	Toleranzgrundsatz nach ISO 8015	
1	Gewinde / threads	0,1 mm		Allg.-Tol. Schnellmont. nach DIN ISO 2768	P	Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindungen)	DIN EN ISO 5817 C
1	Passungen / fits	0,01 mm		Form und Winkelmaß	F	Masse: 13,9 kg	
projection ISO 128 - method 1		Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302		Maßstab: 1 : 5		Material/Oberfläche: Allgemein	
		Vakuum-Dichtflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverlauf zulässig		Halbzeug:			
				Benennung		adCLUSTER advanced MultiCluster.Solutions required dimensions	
				Datum		Name	
				Gezeichnet		BC	
				Freigegeben			
				03 update		25.11.22	
				02 update		20.09.22	
				01 update		15.09.21	
Status		Änderungen		Datum		Name	
						188-200000-69.rdw	
						Ersatz für	
						Ersatz durch	

Adenso
solutions you need

Zeichnungs-nr.
188-200000-69

Revision
03

1 / 1
A2